

お客様各位



梅澤無線電機 株式会社

TEL0120-024768 FAX011-272-5883
技術推進部

UEC-Z77A基板パターン変更のご案内

拝啓

貴社にはますますご発展のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただきまことにありがとうございます。

さてご採用いただいておりますUEC-Z77Aですが、下記のとおり基板パターンを変更いたしましたのでご案内申し上げます。なお、本変更による電気的特性や外形寸法等、仕様にかかわる変更はございませんのでなにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

従来製品ではCN1/2と基板縁の間にパターンを3本通して配線していたため、基板縁と配線パターンが近接しすぎている部分があり、面付けされた基板切り離しのVカットの精度が悪い場合に基板縁のパターンが欠け不良品が発生することがありました。また、1シートには8ユニットが面付けされていたため基板サイズが大きく、製造時の基板たわみで部品実装の精度やはんだ付け外観検査機での検査に障害がある場合がありました。

このため、パターン設計を変更し、CN1/2と基板間に配線パターンは2本までとし、基板縁からパターンまでは従来より多めに間隔をとるようにしました。（ご参考まで、別紙に新旧基板の表面パターン図を添付しておりますのでご参照ください。）

また、基板たわみを避けるため、従来8面付けしていたシートを4面付けに変更しました。

このパターン設計変更に伴う回路・使用部品の変更や、部品配置、外形寸法等、仕様に影響する変更点はございません。

変更時期・シリアル番号

2004年8月以降の製造分より、パターン変更した基板を使用しております。

UEC-Z77A-6 7515432以降

UEC-Z77A-8 製造中

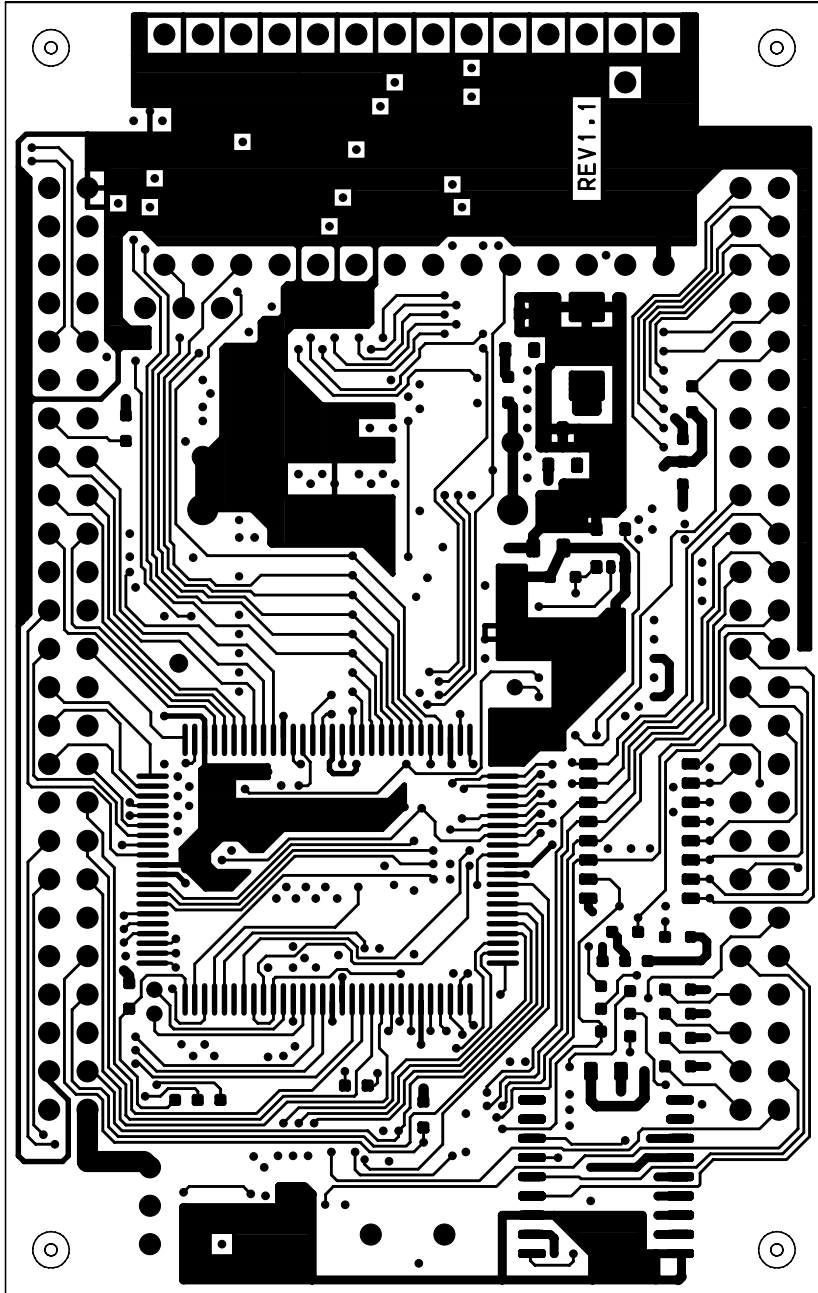
UEC-Z77A-16 14Z0636以降

UEC-Z77A-L M484448以降

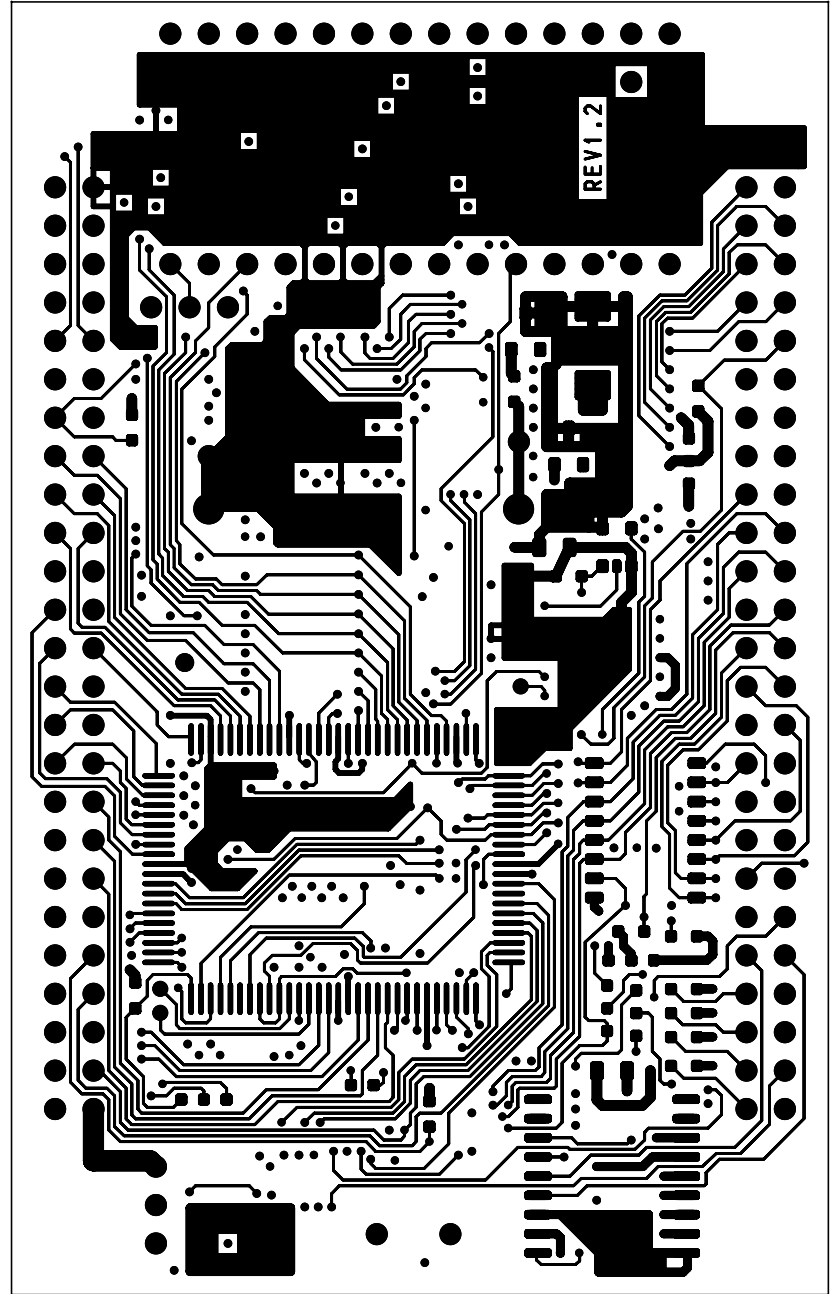
新旧基板の識別

ROMソケット下の基板表面パターンにREV1.1と記されているものは従来基板、REV1.2と記されているものはパターン変更後の基板です。

以上



REV1.1基板表面パターン



REV1.2基板表面パターン